

股票代码：688519

股票简称：南亚新材

南亚新材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称	银河基金、长盛基金、天风证券自营、首创证券、明河投资、国泰海通资管、开源证券、申万宏源资管、惠升基金、大朴资产、上海明溪资产、华能贵诚信托、上海证券自营、中电科投资控股有限公司、天琛私募、国寿安保基金、九方智投、卫宁投资、南京证券、中信证券资管、华泰保兴基金、利位私募、淡水泉投资、弘毅远方基金、诺安基金、玖鹏资产、上海仙人掌私募、上汽集团、牛福私募、艾希控股、永赢基金、惠理基金、乾惕投资、和谐汇一、康盛基金、星山资本、西部自营、宏道、金融街证券、中信证券、正心谷资本等
时间	2026年1月21日-2026年1月22日
地点	南亚新材公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：张柳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问1：公司目前订单情况如何？</p> <p>答：目前公司在手订单良好，生产交付均按计划有序推进。</p> <p>问2：公司整体产能情况及规划情况？</p> <p>答：截至目前，公司已在上海嘉定、江西吉安、</p>

江苏海门、泰国巴真分别投建或规划生产基地。上海生产基地设有N1-N3工厂，N1-N2工厂随着江西生产基地产能的释放，其因能耗、人耗高，效率低停产，N3工厂设计月产能80-90万张左右（含1条试验线）。江西生产基地设有N4-N6工厂，N4工厂设计月产能100万张左右，已达产，N5工厂设计月产能120万张左右，已达产；N6工厂设计月产能120万张，已完成建设并投产。江苏生产基地首个年产360万平米的高端IC封装材料智能工厂的各项建设工作有序推进中，预计到2026年年底前试运行。泰国生产基地已购地并办理地契，公司将视自身及行业发展趋势和地缘政治变化推进投建进度。

问3：公司高速产品海外进展情况如何？

答：公司布局国内市场的同时，积极布局海外市场。已成立了海外技术推广和支持团队，并不断引进行业优秀人才聚焦于高速产品应用推广。目前产品认证推进进展顺利。

问4：2025年覆铜板涨价状况及原因？

答：2025年受原材料价格影响及海外产能溢出等原因已先后带来两轮涨价。行业新一轮涨价系在25年年底启动，主要受原材料成本暴涨加之AI驱动的结构供需重塑叠加行业产能结构调整所带来。

问5：公司如何保持当前竞争优势？

答：一是推进国产化，深耕大客户战略，优化产能利用率，夯实成本竞争力；二是聚焦高速产品优势，推进产品结构转型，扩大战略产品规模，保障性

能稳定与快速交付；三是强化人才管理培养，稳固团队，提升市场竞争应对能力。

问 6：公司高速产品的研发和认证方面取得了哪些新进展？相关产品是否开始批量供货？

答：公司不同等级高速覆铜板可针对应用在不同传输速率的产品，可以满足服务器、数据中心、交换机、光模块等应用领域的需求。公司 M8 及以下等级高速产品已通过国内及海外多家终端客户材料认证，且主要在国内已实现批量供应。

问 7：公司高速产品 2025 年度整体销售情况？

答：公司高速产品起量明显，2025 年占整体营收同比有望翻番。随着公司在高端市场与更多客户合作的深入，2026 年高速产品销量及营收将持续增长。

问 8：公司 IC 载板进展情况？产品是否适用于 ABF 载板？

答：IC 封装基材主流分为 BT 类基材及 ABF 基材。主要被日韩公司垄断。公司主攻类 BT 材料，已针对存储类产品、RF 芯片两大领域布局产品规划，存储已进入量产阶段，RF 正在打样阶段，预计 26 年可以量产。面向该类产品“年产 360 万平方米 IC 载板材料智能工厂建设项目”在江苏生产基地已投建，预计 2026 年年底建成并投入运行。ABF 类材料系公司参股公司江苏兴南创芯材料技术有限公司主攻方向，目前产品正在有序认证推进中。

问 9：公司未来发展方向？

答：公司将聚焦主营、持续创新，锚定覆铜板核心业务，深耕 AI 算力、5G 通信、新能源汽车等。主攻高频高速、IC 封装基材等高端材料的技术研发与量产

	突破，持续深化国产化替代进程。同时，加速全球化产能布局，稳步推进南通、泰国生产基地建设，进一步完善全球供应链体系。以技术创新与产品升级构筑核心价值竞争力，实现“传统产品稳固基本盘，高端产品开拓新增长极”的双轮驱动，致力打造国际领先的电子材料供应商。
附件清单（如有）	
日期	2026年1月23日